

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- B 06 – OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin wewnętrznych ścian.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Wymagania ogólne dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały

2.1. Płytki ceramiczne ściennie szkliwione

Wymagania:

- barwa wg wzorca producenta
- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 Mpa
- odporność szkliva na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C.

2.2. Zaprawy klejące

2.3. Fugi

2.4. Środki gruntujące

2.5. Listwy wykończające

3. Sprzęt

Mieszadła, pacy, kielnie, młotki gumowe, krzyżyki dystansowe.

4. Transport

Dowolne środki transportu.

5. Wykonanie robót

5.1. Podłoża

Podłoża pod okładziny mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych, ściany betonowe lub płyty gipsowo-kartonowe. Podłoże powinno być równe, nie pyłące, pozbawione powłok malarskich, bez zatłuszczeń i śladów bitumów. Przy mocowaniu płytek za pomocą zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej spoiny w murach ceglanych powinny mieć głębokość 10-15mm, a ściana betonowa powinna zostać nakłuta na ok. 50% powierzchni.

5.2. Wykonywanie okładzin przy użyciu zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej

Na ścianach murowych należy wykonać dwuwarstwowy podkład z obrzutki na narzut. Elementy ceramiczne bezpośrednio przed układaniem namoczyć w wodzie przez ok. 3 godz.

Po stwardnieniu podkładu można przystąpić do mocowania płytek, nakładając na ich spodnią stronę zaprawę cementową lub cementowo-wapienną i dociskając je do podłoża. Zaprawa powinna pokrywać całą powierzchnię płytki. Układanie płytek należy rozpocząć od dołu ściany.

5.3. Wykonanie okładzin przy użyciu zaprawy klejącej

Przy mocowaniu elementów z pomocą zapraw klejących nie wolno moczyć płytek, a przygotowując zaprawę klejącą należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji podanej przez producenta zaprawy. Na podłoża z tynku gipsowego, płyt g-k oraz gazobetonu stosować zaprawę o podwyższonej elastyczności.

Podłoże należy zagruntować środkiem polecanym przez producenta zaprawy. Zaprawę nanosić pacą zębatą na niewielkie powierzchnie (ok. 1,0m²) do przyklejenia kilku płytek. W przypadku

dużych płytek zaprawę nanosić również na spodnią stronę płytek. Niedopuszczalne jest punktowe nanoszenie zaprawy. Musi być ona rozprowadzona po podłożu równomiernie.

5.4. Spoinowanie okładzin ceramicznych

Po związaniu zaprawy (zwykłej lub klejącej) należy spoiny pomiędzy płytkami oczyścić i wypełnić zaprawą do spoinowania (fuga). Zaprawę należy przygotować zgodnie z instrukcją producenta. Szerokość i kolor spoin są określone w projekcie wykonawczym. Przy doborze zaprawy do spoinowania należy uwzględnić szerokość spoin.

6. Kontrola jakości robót

- 6.1. Sprawdzenie zgodności wykonania okładzin z dokumentacją i wymaganiami niniejszej specyfikacji za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.
- 6.2. Sprawdzenie podłoża na podstawie protokołów badań.
- 6.3. Sprawdzenie materiałów na podstawie deklaracji zgodności przedstawionych przez dostawców.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m² okładziny ściiennej.

8. Odbiór robót

Powinien obejmować sprawdzenie:

- przyczepności okładziny
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny
- prawidłowości wypełnienia i przebiegu spoin.

Przyczepność:

Brak głuchego odgłosu przy opukiwaniu, sprawdzenie poprzez lekkie opukanie w kilku wybranych dowolnie miejscach.

Odchylenie krawędzi: $\leq 2\text{mm/m}$, sprawdzenie łatą o długości 2,0m.

Odchylenie powierzchni: $\leq 2\text{mm}$, pomiar przeswitu między powierzchnią okładziny, a łatą 2,0m przyłożoną w dowolnym miejscu.

Prawidłowości spoin: $\leq 2\text{mm}$, sprawdzenie wizualnie i przez pomiar odchylen przebiegu spoin w stosunku do naciągniętego sznura.

9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m² powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- moczenie płytek, docinanie płytek,
- ustawienie i rozbiórką rusztowań,
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebić,
- obsadzenie krtek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

10. Przepisy

PN-B-14501:1990 Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne

PN-B-10107:1998 Zaprawy klejące

PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne, definicje, klasyfikacje, właściwości i znakowanie

PN-EN ISO 10545 – do 15:1999 Płyty i płytki ceramiczne
Aprobata techniczne wyrobów.